использованного микроконтроллера в полном объёме будут задействованы в будущем при модернизации прибора.

Использованная литература

- 1. Твайделл Дж., Уэйр А. Возобновляемые источники энергии. М.: Энергоатомиздат, 1990. 392 с.
- 2. Тукфатуллин О.Ф. Разработка эффективных солнечных элементов и фототеплопреобразователей из кристаллического кремния n- и p-типа проводимости для условий жаркого климата: дис. ... док. фил. (Ph.D.): 01.04.10: защищена 13.07.19: утв. 30.08.19. Ташкент, 2019. 149 с.
- 3. Datasheet ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P. Atmel 8-bit Microcontroller with 4/8/16/32 Kbytes In-System Programmable Flash/Atmel Corporation, 2015. 660 p. (www.atmel.com).
- 4. Universal Serial Bus Specification Revision 1.1/Compaq Computer Corporation, Intel Corporation, Microsoft Corporation, NEC Corporation, 1998. 327 p. (www.usb.org).
- 5. Datasheet L78xx, L78xxC, L78xxAB, L78xxAC. Positive voltage regulator ICs/STMicroelectronics, 2012. 57 p.

ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА НА КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ, ЛЕГИРОВАННОГО ИОНАМИ СО

¹Б. Э. Эгамбердиев, ²Ф.М. Исроилов, ¹Н.М. Рахимова

¹Научно-исследовательский институт физики полупроводников и микроэлектроники, Национальный университет Узбекистана,
²Джиззакский государственный политехнический институт E-mail: bahrom_prof@mail.ru, isroilov.Faxriddin@bk.ru

Научная проблемы актуальность исследования процесса дефектообразования скрытых слоев переходных металлов, полученных кремниевых ионным легированием В подложках, определяется необходимостью глубокого понимания основных более процессов, происходящих во время формирования этих структур. С практической точки зрения эти исследования актуальны, прежде всего, в связи с возможностью формирования гетероструктур Si/CoSi₂/Si, пригодных для применения в качестве локальных контактов и межсоединений в трехмерных системах металлизации, а также в качестве современных быстродействующих приборов, таких как, например, транзисторы с «проницаемой» или металлической базой.

Возможность детального исследования системы $Si\text{-}CoSi_2$ может служить моделью для изучения дефектообразования других переходных металлов в кремнии, а также для исследования границы раздела фаз силицид металла/кремний, в связи с ее достаточно простым способом получения и изучения [1-2]

В данной работе приводится ряд новых оригинальных результатов по исследованию свойств влияние отжига на кристаллическую структуру поверхности кремния, легированного ионами кобальта. Выбор в качестве компенсирующей примеси кобальта обусловлен тем, что в широкой области температур, состояние атомов примеси в решётке кремния достаточно стабильно (100÷450°С) и соответственно параметры кремния легированного им. Технология легирования кремния кобальта с заданными параметрами разработана и освоена нами практически на промышленном уровне и не требует дополнительных операций (механических, химических и т. д.) после диффузионного легирования. Можно легировать кобальта на кремнёвые пластины достаточно большой площади, более 100 см², что очень важно для промышленного и серийного выпуска преобразователей температуры с воспроизводимыми параметрами.

Были экспериментальные проведены исследования концентрационных профилей распределения атомов кобальта, имплантированных в кремний с энергией $E_0 = 40$ кэВ с вариацией дозы облучения в интервале $10^{15} \div 10^{17}$ ион/см². В качестве исходного материала использован кремний марки КДБ с удельным сопротивлением Ом см., исследования проводились использованием методов вторичной спектрометрии, дифракция быстрых ионной массэлектронов отражение, резерфордского обратного рассеяния, ВИМС и электронной Оже- спектроскопии.

Исследовались кристаллическая структура поверхности и электрофизические свойства ионно-легированных слоев. На рис.1 представлены электронные картины, полученные от поверхности Si до и после ионного легирования, а также после термической обработки при разных температурах.

Как видно из рисунка, в случае чистого кремния электронная картина имеет сплошной и равномерный вид, так как образцы были шлифованы и полированы (рис.1.а.). После ионного легирования в зависимости от дозы облучения и типа ионов электронная картина существенно меняется. Вид картины от гладкой поверхности переходит к картине шероховатой или матовой (рис.1.б.).

Температурный отжиг сильно влияет на состояние имплантированных образцов. При малых значениях дозы облучения и термическом отжиге, в случае Со до 800^{0} С существенных изменений электронной картины не происходит. При температуре 800^{0} С и выше на картине наблюдаются некоторые окантованные области, характерные для монокристаллов. Элементный анализ этих окантовок методом электронной ОЖЕ спектроскопии показал, что они состоят, в основном, из атомов Si и Со и частично кислорода. Амплитудное состояние ОЖЕ пиков кремния и кобальта позволяет утверждает, что эти области являются силицидами типа CoSi₂





а б

Рис.1. Электронно – микроскопические картины поверхности чистого кремния (а) и поверхности ионно-легированной, $Co^+(\delta)$.

Результаты ЭТИХ экспериментов доказывают, ЧТО поверхностные процессы зависят от температуры и дозы легирующих примесей [8-9]. Совершенно иные результаты получаются кремниевых образцов большими дозами. рис.2 легировании представлены электронные картины поверхности кремния, легированного ионами Со с дозой 10^{17} ион/см² после отжига при температуре 950^{0} С. Как видно из рисунка, окантованные области как бы слились, образуя сплошной слой в виде монокристалла с большим количеством дефектов.

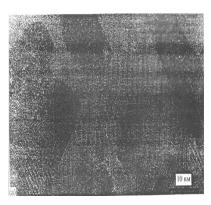


Рис.2 Микрофотография поверхности кремния, легированного ионами Co^+ с дозой 10^{17} ион/см 2 после термического отжига при 950^{0} С.

Дальнейшее повышение температуры отжига до 1100°C приводит к существенному изменению состояния поверхности. Электронная картина переходит от "эпитаксиальной" до аморфной поверхности (рис.3).

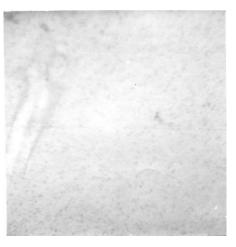


Рис.3. Микрофотография поверхности кремния, легированного ионами ${
m Co}^+$ с дозой 10^{17} ион/см 2 после термического отжига при температуре $1100^0{
m C}$.

Эти изменения относятся не только к структуре, но и к составу поверхности [3].

Исследования показали, что ионное легирование сильно влияет на структуру поверхности в зависимости от дозы и энергии ионов. После легирования поверхность становиться шероховатой. На эту структуру сильно влияет температурный отжиг. При температуре выше 800° C на поверхности образуются некоторые окантованные области, характерные для монокристалла.

Структурные изменения в зависимости от дозы облучения и температуры отжига для кобальта с дозой облучения 10^{17} ион/см 2 после отжига при температуре выше 800^{0} С на поверхности образуется слой вида монокристалла с большим количеством дефектов. Дальнейшее повышение

температуры до 1100^{0} С приводит к образованию аморфного слоя на поверхности.

Проведен анализ влияния набранной дозы и высокотемпературного отжига на дефектообразование в ионно-имплантированных слоях. Исследованы скрытые слои дисилицида кобальта в кремнии, полученные ионно-лучевым синтезом при различных режимах имплантации и отжига.

Показано, что изменение набранной дозы меняет глубину залегания и толщину слоев дисилицида кобальта. Варьируя дозу можно изменять залегания глубину толщину слоя CoSi₂. Под И влиянием высокотемпературного отжига происходит значительное уменьшение выхода альфа-частиц рассеянных на кремнии и кобальте на спектрах каналирования РОР, что указывает на то, что большинство радиационных дефектов устраняется происходит улучшение кристалличности структуры имплантированного слоя.

Использованная литература

- 1. Эгамбердиев Б.Э., Холлиев Б.Ч., Маллаев А. С., Зоирова М. Э., Эшонхонов А. "Получение пленок CoSi₂/Si (100) и анализ их морфологии и стехиометрии методами молекулярно-лучевой, твердофазной и реактивной эпитаксии" ЭОМ, Молдова, 2007, №1, С.88-92.
- 2. Biesinger M.C., Paynec B.D., Grosvenor A.P., Laua L.W., Gersonb A.R., Smart R. Resolving surface chemical states in XPS analysis of first row transition metals, oxides and hydroxides: Cr, Mn, Fe, Co and Ni // Appl. Surf. Sci. 2011. V. 257, No. 7. P. 2717–2730. doi: 10.1016/j.apsusc.2010.10.051.
- 3. Эгамбердиев Б.Э. , Маллаев А. С. Кремниевые силицидные структуры на основе ионного легирования. Т.:изд. «Наука и технология» 2019г. 168с.

ВЛИЯНИЕ γ -ОБЛУЧЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАТНОЙ ВЕТВИ ВАХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ПЛЕНОК СDTE

А.С. Ачилов¹, Р.Р. Кобулов¹, Д.М.Ёдгорова¹, Ж.Б. Урокбойев² Физико-технический институт, Академия Наук Республики Узбекистана¹, Джизакский государственный педагогический институт имени А. Кодири².

 $E\text{-mail: } \underline{alimardon.uzb@mail.ru}$

В данное время теллурид кадмия (CdTe) широко применяется для создания детекторов рентгеновского (X) и γ - излучений [1]. Крупноблочные поликристаллические пленки CdTe со столбчатой структурой кристаллитов обладают рядом уникальных преимуществ, таких